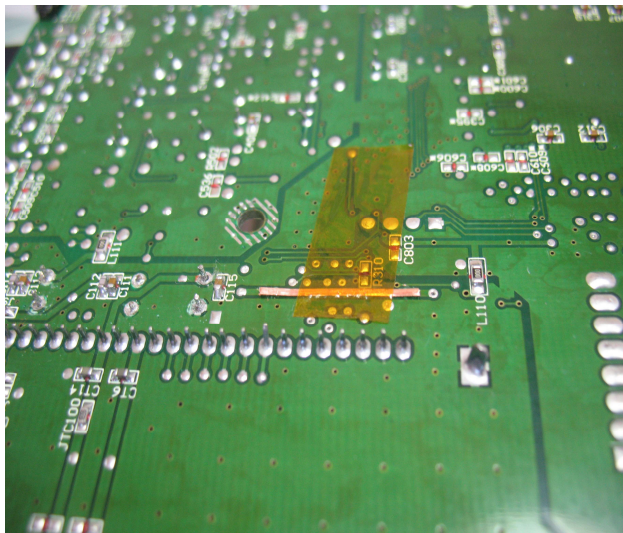




Construcción y Montaje de la PCB (nivel 2): Soldadura avanzada de componentes electrónicos y reparación de placas.

OBJETIVOS	CONTENIDOS
Avanzar en los conceptos implicados en la soldadura utilizada en la industria electrónica, en la tecnología "Surface Mounted" (SMT), estudiando las diferentes técnicas para la soldadura de prototipos, pequeñas y grandes series, así como técnicas de retrabajo y reparación de placas de circuito impreso, aplicando técnicas y criterios basados en estándares internacionales (IPC).	Contenidos teóricos • Tecnología de componentes THD y SMD. • Encapsulado componentes THD/SMD. • Electricidad estática y protección componentes. • Componentes sensibles a la humedad. • Técnicas de soldadura. ○ Por contacto. ○ Por ola. ○ Por refusión. • Soldadura con / sin plomo. • Soldadura manual. ○ Estaciones de soldadura. • Soldadura por refusión • Comprobación de circuitos. ○ Introducción estándares IPC. • Documentación. ○ Fallos comunes y sus soluciones Contenidos prácticos • Prácticas desoldadura componentes THD y SMD. • Uso de estaciones de soldadura manual. ○ Soldadura / desoldadura por contacto. ○ Soldadura / desoldadura por aire caliente. • Montaje, soldadura y comprobación PCB SMD. ○ Colocación manual y soldadura manual. ○ Colocación mediante posicionador y soldadura por refusión. • Reparación placas SMD. ○ Pistas cortadas. ○ Puentes. ○ Quemaduras en placa. ○ Etc.

Curso subvencionado al 100%



Europar Batasunak
kofinantzatuta
Cofinanciado por
la Unión Europea

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: SALESIANOS DEUSTO
Avda. Lehendakari Aguirre, 75 48014 - Bilbao Tfno.: 944 472 650
www.salesianosdeusto.com informacion@salesianosdeusto.com